

DEUTSCHLAND
Seica

KATALOGUE

PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

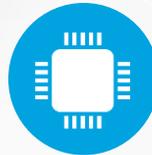


www.seica.com/de/

INHALTSVERZEICHNIS



P. 03 Flying-Probe-Test



P. 07 ICT In-Circuit-Test



P. 13 THT/CC-Inspektion

P. 14 Laserlöten



P. 15 Markierung / Lasermarkierung

P. 16 Handling Systeme

P. 19 Linienüberwachung



Seica

PILOT H4 NEXT>

FLYING-PROBE-TESTER FÜR PCBA-TESTS

Mit der als Option integrierten SMEMA-Schnittstelle ist die Pilot H4 Next>-Series eine traditionelle Flying-Probe-Testplattform, bei der der Bediener nicht mehr vor dem Testsystem anwesend sein muss. Dies ist die ideale Lösung für mittlere und große Produktionsmengen horizontaler Tests.

EIGENSCHAFTEN

- Testsystem mit 4 elektrischen Flying Probes
- In-Circuit- und Funktionstest, On Board Programming, Boundary-Scan, FEASA und optischer Test
- SMEMA-kompatible, manuelle und automatische horizontale Architektur, leicht in eine Produktionslinie integrierbar (Option)
- Automatische Programmierung mit Datenimport durch Valor Process Preparation von Valor MSS
- Verwaltung von festen Kanälen und zusätzlichen Netzteilen zusätzlich zu Flying Probes
- Offline-Programmier- und Reparaturstationen
- Reparaturwerkzeuge: PWMON (Analyse der Platine unter Spannung), thermischer Scan, DES (Software zur Beurteilung der Fehlerwahrscheinlichkeit)
- Kompatibel mit Industrie 4.0 / Hermes / CFX / MES)



Seica

PILOT V8 NEXT>

FLYING-PROBE-TESTER FÜR PCBA-TESTS

Die Pilot V8 Next>-Series ist die komplette Lösung für ein Maximum an Leistungsfähigkeit: hohe Testgeschwindigkeit, für geringe bis mittlere Produktionsvolumen, für die Fertigung oder Reparatur. Durch die vertikale Architektur können beide Seiten der Platine gleichzeitig getestet werden

EIGENSCHAFTEN

- Testsystem mit 8 elektrischen Flying Probes (4 auf jeder Seite)
- In-Circuit- und Funktionstest, On Board Programming, Boundary-Scan, FEASA und optischer Test
- Vertikale Architektur, um die Schwingungen der Platine zu reduzieren
- Automatische Programmierung mit Datenimport durch Valor Process Preparation von Valor MSS
- Manuelles oder automatisches Laden der Platine (optionale Stapel-/Entstapelvorrichtung)
- Offline-Programmier- und Reparaturstationen
- Doppelseitige Barcode- und 2D-Code-Lesefähigkeit
- Reparaturwerkzeuge: PWMON (Analyse der Platine unter Spannung), thermischer Scan, DES (Software zur Beurteilung der Fehlerwahrscheinlichkeit)



Seica

PILOT VX NEXT>

FLYING-PROBE-TESTER FÜR PCBA-TESTS

Der Pilot VX Next>Series ist die schnellste Lösung mit maximaler Leistung : sehr hohe Testgeschwindigkeit, geeignet für niedrige bis mittlere Produktionsvolumina, Herstellung oder Reparatur. Seine Architektur ermöglicht es, beide Seiten der Karte gleichzeitig zu testen.

EIGENSCHAFTEN

- System ausgestattet mit 8 beweglichen Köpfen (4 auf jeder Seite)
- Möglichkeit, bis zu 60 Sonden gleichzeitig zu kontaktieren
- X- und Y-Achsenbewegungen mit sehr hoher Geschwindigkeit (50% schneller als ein Pilot V8).
- ICT- und Funktionsprüfung, Programmierung auf Karte, Boundary Scan, FEASA und Optik
- Lesefähigkeit von Barcodes und 2D-Codes auf beiden Seiten
- Große Auswahl an Automatisierungstechnik für den Vollautomatikbetrieb



Seica

PILOT BT NEXT>

FLYING-PROBE-TESTER ZUM TESTEN VON EF-BATTERIEN

Um den technischen Anforderungen beim Testen von Lithium-Ionen-Batterien von Elektrofahrzeugen (EF) gerecht zu werden, hat Seica die Serie Pilot BT Next> entwickelt. Mit einem Seica Handlingsystem oder einem vom Kunden entworfenen oder ausgewählten kundenspezifischen System kann der Tester alle Batterietypen testen.

EIGENSCHAFTEN

- Bis zu 4 unabhängige Testköpfe, von bürstenlosen Synchronmotoren angetrieben (XYZ)
- Jeder der vier Köpfe ist mit einer Miniaturvorrichtung ausgestattet, um in einer einzigen Bewegung bis zu vier Einzelzellen in einer Ausrichtung auf die Achse X oder Y testen zu können
- Vier thermisch stabilisierte und isolierte Widerstandsmessgeräte, die die Messung des Bondwiderstands einer einzelnen Batteriezelle auf der gemeinsamen Platte ermöglichen
- Digitaler Signalprozessor (DSP) von 200 MHz zur Verarbeitung von analogen Messungen, um eine schnelle und effiziente Verarbeitung zu gewährleisten
- Der Tester kann sehr genaue Kelvin-Tests von 16 Zellen gleichzeitig durchführen, wobei Produktionsraten von fast 2400 Batteriezellen pro Minute erreicht werden



Seica

RAPID H4 NEXT>

FLYING-PROBE-TESTER FÜR FLEX – UND SUBSTRAT-TESTS

Um den spezifischen Anforderungen des Marktes zu entsprechen, wo die meisten Keramiken Testpunkte auf einer Seite haben, hat Seica die Tester Rapid H4 Next>Series eingeführt, die für manuelles oder automatisches Beladen mit 4 Probes auf der Oberseite ausgestattet ist.

EIGENSCHAFTEN

- 4 unabhängige Flying Probes
- Aufgrund der Linearführungstechnologie der dritten Generation kann die Rapid H4 Next>Series eine sehr hohe Geschwindigkeit mit einer maximalen Präzision und Messwiederholbarkeit erreichen
- 1 HD CCD Kamera auf einer Probe für den optischen Abgleich und für Vision Tests (Top)
- Testbereich bis 540 mm x 610 mm (21" x 24")
- 2-Draht-Messungen und Kelvin-Tests (4 Drähte)
- Möglichkeit zum Testen von Substraten oder Flex Platinen im Reel-to-Reel-Verfahren (spezifische Version)
- Vakuumentisch als Option



Seica

RAPID V8 NEXT>

FLYING-PROBE-TESTER FÜR PCB-TESTS

Der Rapid V8 Next>Series kombiniert die Vielseitigkeit und die kleine Standfläche eines vertikalen Systems mit der Automatisierung von Testern mit horizontaler Architektur. Er entspricht den höchsten Anforderungen an die Vielseitigkeit kombiniert mit hohen Leistungsstandards.

EIGENSCHAFTEN

- Test von Embedded Components, Keramiks substraten, flexiblen Platinen und Printed Circuit Boards (PCBs)
- 8 unabhängige Flying Probes
- 2 CCD Kameras (1 auf jeder Seite)
- Testbereich bis 540 mm x 610 mm (21" x 24")
- Hochohmige Isolationsprüfungen, Hochspannungsprüfungen
- Soft-Touch-Eigenschaften
- In-Circuit-Tests von „Embedded Components“ als Option



Seica

MINI 80 NEXT>

ALL-IN-ONE-INSTRUMENT FÜR PARAMETRISCHE TESTS

Die Tester der Mini 80 Next>Series stellen die maximale Miniaturisierung der heute am Markt verfügbaren ATE-Tester dar. Im 19"/2U-Rack stehen denjenigen, die Parametertests mit wenigen Testpunkten suchen, alle Leistungsfähigkeiten einer automatischen Testausrüstung (Automated Test Equipment – ATE) zur Verfügung.

EIGENSCHAFTEN

- In ein 19-Zoll-Rack integrierbar (ohne PC geliefert)
- Manueller oder kundenspezifischer Testadapter
- 3 Steckplätze verfügbar: bis zu 192 analoge Kanäle oder 32 digitale Kanäle
- 1 Netzteil für Benutzer (0-30 V / 1 A)
- Universeller On-Board-Programmierer (bis zu 4 parallel verfügbar)
- Verwaltung von Boundary-Scan-Tests
- Lesen von Barcodes und 2D-Codes und automatische Sammlung statistischer Daten
- Automatische Programmierung mit CAD Datenimport



Seica

MINI 200 NEXT>

ALL-IN-ONE-INSTRUMENT FÜR IN-CIRCUIT-/FUNKTIONSTESTS

In der ATE-Welt stellen die Tester der Mini 200 Next>Series einen exzellenten Kompromiss in Bezug auf Integration und Skalierbarkeit dar. Alle wichtigen Ressourcen, um einen In-Circuit-Test zu erzeugen, sind in einer 19"/6U-Rackarchitektur inklusive PC verfügbar.

EIGENSCHAFTEN

- In ein 19-Zoll-Rack integrierbar (mit integriertem PC geliefert)
- Manueller oder kundenspezifischer Testadapter
- 10 Steckplätze verfügbar: bis zu 640 analoge Kanäle oder 92 digitale Kanäle
- 3 Netzteile für Benutzer (0-30 V / 1 A)
- Universeller On-Board-Programmierer (bis zu 4 parallel verfügbar)
- Verwaltung von Boundary-Scan-Tests
- Funktionstestsequenzen-Management über NI (Labview/Teststand) oder mit VIVA Betriebssystem von SEICA
- Automatische Programmierung mit CAD Datenimport



Seica

COMPACT CUBE NEXT>

ICT & FUNKTIONSTESTER

Der Bedarf, immer kleinere Boards zu testen, verbunden mit dem Bedarf an Flexibilität und Integration in den meisten Fertigungsumgebungen führte zur Entwicklung des Testers Compact Cube Next>Series, dem kleinsten Tester aus der Compact-Familie, aber mit großem Potential in verschiedensten Betriebsumgebungen.

EIGENSCHAFTEN

- Weniger als 68 cm hohes Rack, dank der vier Räder leicht lenkbar
- Vollständig integriertes System mit integriertem PC
- Manueller oder kundenspezifischer Testadapter
- 3 Steckplätze verfügbar: bis zu 192 analoge Kanäle oder 32 digitale Kanäle
- Funktionstestsequenzen-Management über NI (Labview/Teststand) oder mit VIVA Betriebssystem von SEICA
- Automatische Programmierung mit CAD-Datenimport
- Vollständig personalisierte Benutzeroberfläche (MyView), selbst mit Verwendung von Teststand
- Vereinfachte funktionale Umgebung dank der Verwendung von QuickTest



Seica

COMPACT RT NEXT>

ICT & FUNKTIONSTESTER

Seica erfüllt die Anforderungen des anhaltenden Trends zur Miniaturisierung von elektronischen Leiterplatten durch die Einführung der neuen Compact RT Next>Series, einem vollautomatischen System auf Basis eines Drehtisches, das ideal für die Produktion von mittleren bis hohen Volumina ist.

EIGENSCHAFTEN

- Receiver und Drehtisch inklusive
- Kann im Automatikmodus (durch Roboter / Cobot) oder im manuellen Modus (durch Bediener) betrieben werden
- Laden von Karten während der Produktionszeit
- Entwickelt für automatisierte Fertigungslinienkonzepte: Compact RT Next>Series in Linie oder im Kreis angeordnet
- Identifikation von Schnittstellen in RFID #
- 10 Steckplätze verfügbar: bis zu 640 analoge Kanäle oder 92 digitale Kanäle
- ICT- und Funktionsprüfung, Programmierung auf Karte, Boundary Scan und FEASA
- Automatische Programmierung mit CAD-Datenimport



Seica

COMPACT TK NEXT>

ICT & FUNKTIONSTESTER

Die Konfiguration der Compact TK Next>Series ist durch ein hohes Maß an Ergonomik (WCM-Standard) gekennzeichnet, kleine Standfläche, leichte Wartbarkeit, geringe Leistungsaufnahme und verbesserte Bediener-sicherheit. Das System kann leicht in jede Produktionsumgebung integriert werden.

EIGENSCHAFTEN

- Kleine Standfläche und WCM-Ergonomie
- Existiert in der Version 1 JOB oder 2 JOB (Erweiterungskabinett)
- Pneumatischer Receiver mit Stützfingern und kapazitiven Sonden (Option) auf der Oberseite
- 24 Steckplätze verfügbar: bis zu 1536 analoge Kanäle oder 736 digitale Kanäle
- In-Circuit- und Funktionstest, On Board Programming, Boundary-Scan, FEASA
- Automatische Programmierung mit CAD-Datenimport
- Digitaler Signalprozessor (DSP) von 200 MHz zur Verarbeitung von analogen Messungen, um eine schnelle und effiziente Verarbeitung zu gewährleisten
- Vollständig personalisierte Benutzeroberfläche (MyView), selbst mit Verwendung von Teststand



Seica

COMPACT DIGITAL/XL/LR NEXT>

ICT & FUNKTIONSTESTER

Die Compact Digital Next>Series ist ein anspruchsvolleres Testsystem mit Leistungsfähigkeiten, die über einen einfachen logischen Analysator hinausgehen. Das System ist die Antwort von Seica auf die ständige Nachfrage nach dem Testen integrierter Bauelemente mittels vektorbasierter Techniken und spezieller Protokolle wie Boundary-Scan.

EIGENSCHAFTEN

- Mit den Schnittstellen IFR/Aeroflex/Teradyne (Compact LR) kompatibler Vakuumreceiver
- Kann im automatischen Betrieb (mit Roboter / Cobot) oder im manuellen Betrieb (mit Bediener) arbeiten
- 54 Steckplätze verfügbar (XL Version): bis zu 2048 analoge Kanäle oder 2048 Hybridkanäle zum Multiplexen im Verhältnis 1:8
- In-Circuit- und Funktionstest, On Board Programming, Boundary-Scan, FEASA
- Automatische Programmierung mit CAD-Datenimport
- Digitaler Signalprozessor (DSP) von 200 MHz zur Verarbeitung von analogen Messungen, um eine schnelle und effiziente Verarbeitung zu gewährleisten
- Vollständig personalisierte Benutzeroberfläche (MyView), selbst mit Verwendung von Teststand



Seica

COMPACT MULTI NEXT>

ICT & FUNKTIONSTESTER

Die Vielseitigkeit und Skalierbarkeit des Testsystems Compact Multi Next>Series ist perfekt geeignet für die Integration von externer Instrumentierung, Fähigkeiten und Techniken in einem einzigen funktionellen Testprogramm für den Bedarf der Industrie und Automobilindustrie.

EIGENSCHAFTEN

- Existiert in der Version 1 JOB oder 2 JOB (Erweiterungskabinett)
- Pneumatischer Receiver mit Testnadeln und kapazitiven Sonden (Option) auf der Oberseite
- Freier Platz, um externe Instrumente zu integrieren
- 24 Steckplätze verfügbar: bis zu 1536 analoge Kanäle oder 736 digitale Kanäle
- In-Circuit- und Funktionstest, Programmierung auf Platine, Boundary-Scan, FEASA
- Bus und Stromversorgungsmatrix (HRELE-Modul)
- Verwaltung von Kommunikationsprotokollen (seriell, USB, CAN, LIN, K-line, GPIB etc.)
- Vollständig personalisierte Benutzeroberfläche (MyView), selbst mit Verwendung von Teststand



Seica

COMPACT SL NEXT>

ICT & FUNKTIONSTESTER

Das Testsystem Compact SL Next> Seica bietet eine komplett automatisierte Lösung mit kleiner Standfläche (WCM-Standard) über ein integriertes, SMEMA-kompatibles Fördersystem, das eine automatische Handhabung von Platinen und eine leichte Integration in Produktionslinien mit hohen Stückzahlen ermöglicht.

EIGENSCHAFTEN

- Existiert in der Version 1 JOB oder 2 JOB (Erweiterungskabinett)
- Kleine Standfläche und WCM-Ergonomie
- Verwendung auf einer automatisierten Insel oder direkt auf der Produktionslinie
- 24 Steckplätze verfügbar: bis zu 1536 analoge Kanäle oder 736 digitale Kanäle
- In-Circuit- und Funktionstest, Programmierung auf Platine, Boundary-Scan, FEASA
- Funktionstestsequenzen-Management über NI (Labview/Teststand) oder mit VIVA-Betriebssystem von SEICA
- Verwaltung von Kommunikationsprotokollen (seriell, USB, CAN, LIN, K-line, GPIB etc.)
- Kompatibel mit Industrie 4.0 / Hermes / CFX / MES



Seica

COMPACT DIGITAL TOWER NEXT>

ICT & FUNKTIONSTESTER

ist Seica's Antwort auf die konstante Nachfrage nach dem Ersatz von In-Line-Systemen durch eine Schnittstelle ähnlich der von Aeroflex. Sie ist in 3 verschiedenen Konfigurationen erhältlich, die das gleiche Tower-Gehäuse haben. Die Maschine verfügt über 2 Standard-Racks, die im unteren Teil angebracht sind, um die Kabellänge zu reduzieren.

EIGENSCHAFTEN

- Einzel-JOB
- 2-JOB eingebaute Konfiguration: 2 unabhängige Systeme sind in einem kombiniert.
- 4-JOB eingebaute Konfiguration: 4 unabhängige Systeme sind in einem kombiniert. Seica-Systeme basieren auf einer Kernsoftware und Hardware-Modularität.
- Bei der Multi-Job-Lösung verwaltet der Master-PC alle 4 Slave-PCs. Auf diese Weise kann der Bediener 4 Jobs gleichzeitig benutzen.
- Multiplexing Hybrid1 Kanäle (1:8) Bis zu 2048, bis zu 1024 pro Job, bis zu 448 pro Job.
- Direkte Hybrid1 Kanäle (1:1) Bis zu 832, bis zu 412 pro Job, bis zu 128 pro Job.
- Skalierbarkeit für den Funktionstest
- OnBoard Programmierung



Seica

COMPACT BMS NEXT>

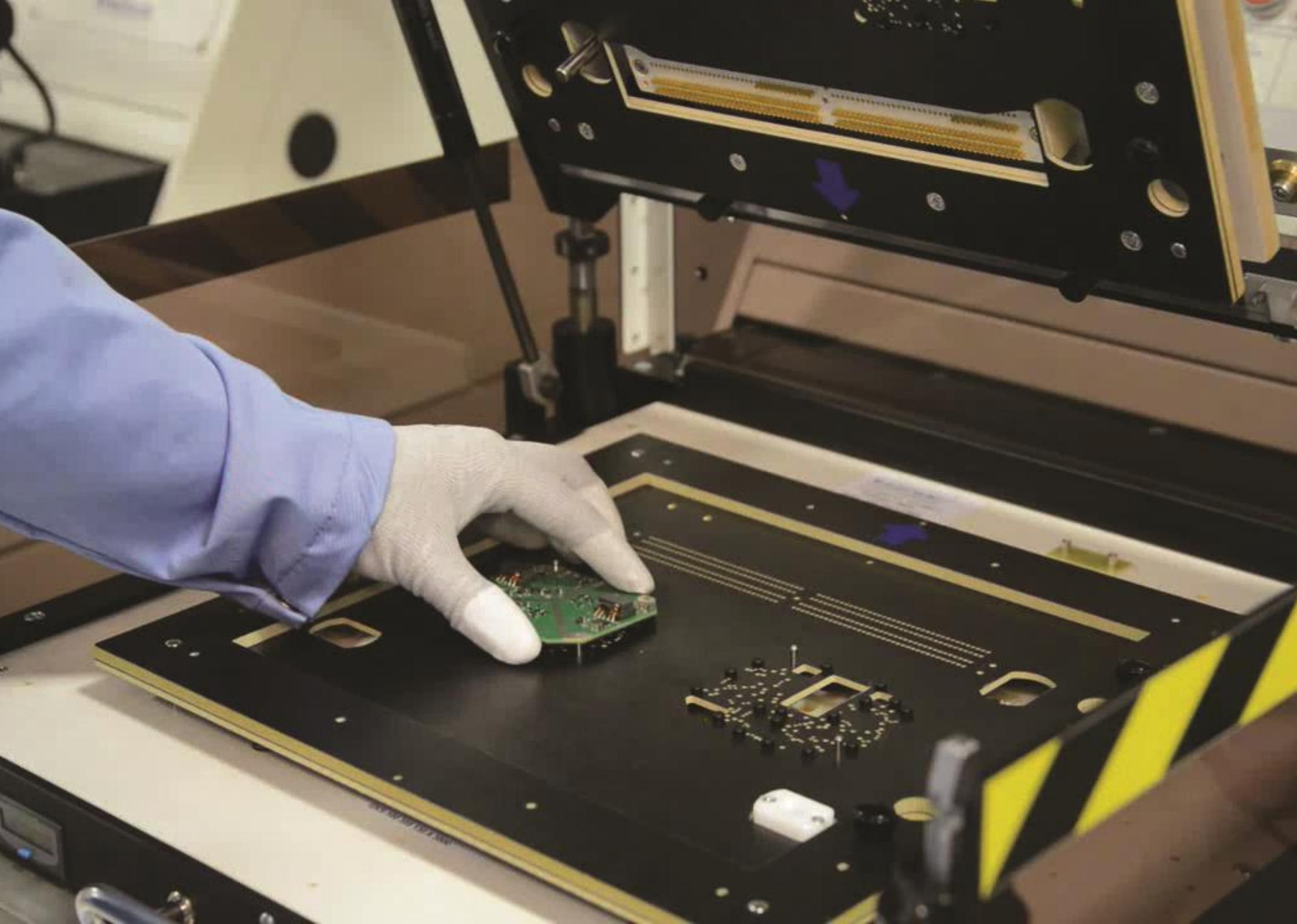
BMS FUNKTIONSTESTER (BATTERY MANAGEMENT SYSTEM)

Die nächste Generation von Batterien bietet faszinierende Leistungen in Bezug auf Kapazität und reduzierte Lade- und Entladezeiten. Dieses Ergebnis erfordert eine genaue Überwachung und Verwaltung der einzelnen Zellen durch das Battery Management System (BMS).

EIGENSCHAFTEN

- Kommunikationsverbindungen: Serial, USB, CAN, LIN, FlexRay, MOST, Ethernet, Ethernet 100 BaseT1
- Unterstützte Video-Schnittstellen: RGB, S-Video, VGA, HDMI, CVBS, LVDS
- Generationen und Erfassung Radiofrequenztest: BT, BLE, WiFi, Mobiltelefone
- GNSS-Testsystem: GPS, Glonass, Beidou, Galileo-Satellit und andere Simulatoren
- OnBoard-Programmierungsfähigkeit (OBP)
- Boundary-Scan-Testfähigkeit
- Option für parallelen Test bis zu 4 JOBS





Seica

DRAGONFLY CC NEXT>

OPTISCHE INSPEKTION VON CONFORMAL COATING

Die Dragonfly CC Next>Series ist die neue AOI-Lösung von Seica, um das Aufbringen von Schutzbeschichtungen zu inspizieren. Die Kombination der mehrfarbigen LED-Beleuchtung, der UV-LED-Beleuchtung und der Farbkamera mit linearer Abtastung ermöglicht eine klare Inspektion der Schutzbeschichtung.

EIGENSCHAFTEN

- Basierend auf einer schnellen und präzisen Scanner Technologie kombiniert mit UV-Licht, die das Vorhandensein eines UV-Tracers in der inspizierten und aufgetragenen Schutzbeschichtung vorschreibt
- Ermöglicht, das Vorhandensein der Schutzbeschichtung in 2D zu überprüfen und die einheitliche Auftragsdicke ausnahmslos zu messen (Option)
- Objektives und reproduzierbares vollautomatisches System, das nicht vom Bediener abhängig ist
- SMEMA-kompatibler, integrierter Förderer, leicht in eine Produktionslinie oder Desktop-Ergonomie integrierbar
- CCD-Kamera, 18 Mpxl oder 42 Mpxl
- Offline-Programmierung möglich (Option)
- Kompatibel mit Industrie 4.0 / Hermes / CFX / MES)



Seica

DRAGONFLY THT NEXT>

OPTISCHE INSPEKTION VON DURCHGESTECKTEN BAUTEILEN

Die Dragonfly THT Next> kommt der Serie Dragonfly CC Next> technisch sehr nahe, denn sie basiert ebenfalls auf einer Scanner Technologie mit kompletter Abtastung der PCB. Sie ermöglicht die tiefe Inspektion von Lötstellen von durchgesteckten Bauteilen.

EIGENSCHAFTEN

- Die Kombination aus mehrfarbiger LED-Beleuchtung und der Farbscankamera bietet eine tiefe Inspektion des Lötstellenmeniskus und der Kurzschlusserkennung
- Vollständige Scan-Erfassung der Leiterplattenoberfläche und nicht nur der Bauteile, die die Erkennung von Lötkegeln ermöglicht
- Objektives und reproduzierbares vollautomatisches System, das nicht vom Bediener abhängig ist
- Werkzeug, das perfekt hinter Wellenlöt- oder Selektivlötgeräten platziert werden kann
- SMEMA-kompatibler, integrierter Förderer, leicht in eine Produktionslinie oder Desktop-Ergonomie integrierbar
- CCD-Kamera, 18 Mpxl oder 42 Mpxl
- Kompatibel mit Industrie 4.0 / Hermes / CFX / MES)



Seica

FIREFLY B60 NEXT>

AUTOMATISIERTES SELEKTIVLÖTEN MIT LASER

Die neue Firefly B60 Next>Series ermöglicht ein extrem effizientes Löten an jeder Art von Platine, sei es mit bleifreien oder bleihaltigen Legierungen. Die Energieversorgung durch eine Laserquelle ermöglicht eine genaue Parametrierung von jedem Punkt.

EIGENSCHAFTEN

- Basierend auf einer parametrierbaren Lasertechnologie, die eine punktuelle Anpassung der für das Löten benötigten Leistung ermöglicht
- Auf der Unterseite der Platine installierter Laser in Form eines Donutstrahls, um die Energie nur auf das Pad und nicht auf das Loch abzustrahlen, wodurch Schäden an Komponenten vermieden werden
- Wechsel zwischen bleihaltigen und bleifreien Prozessen, indem einfach die Lotdrahtspule ausgewechselt wird
- Objektives und reproduzierbares vollautomatisches System, das nicht vom Bediener abhängig ist
- SMEMA-kompatibler, integrierter Förderer, leicht in eine Produktionslinie oder Desktop-Ergonomie integrierbar
- Nach dem Einschalten sofort lötbereit, ohne Vorwärmung, was sie zu einem äußerst flexiblen Werkzeug in der Fertigungsumgebung macht



Seica

FIREFLY T60 NEXT>

AUTOMATISIERTES SELEKTIVLÖTEN MIT LASER

Gleiches Funktionsprinzip wie bei der Firefly B60 Next>, die Firefly T60 Next>Series führt den Laserlötprozess der Leiterplatte oder der Anwendung aber von oben aus. Diese Konfiguration ist besonders für automatisierte Prozesse auf einer vorhandenen Förderstrecke geeignet.

EIGENSCHAFTEN

- Auf integrierte Anwendungen ausgerichtet
- Basierend auf einer parametrierbaren Lasertechnologie, die eine punktuelle Anpassung der für das Löten benötigten Leistung ermöglicht
- Auf der Oberseite installierter Laser in Form eines Donutstrahls, um die Energie nur auf das Pad und nicht auf das Loch abzustrahlen, wodurch Schäden an Komponenten vermieden werden
- Wechsel zwischen bleihaltigen und bleifreien Prozessen, indem einfach die Lotdrahtspule ausgewechselt wird
- Objektives und reproduzierbares vollautomatisches System, das nicht vom Bediener abhängig ist
- SMEMA-kompatibler, integrierter Förderer, leicht in eine Produktionslinie oder Desktop-Ergonomie integrierbar
- Leicht in eine Automobil-Fertigungslinie für Anwendungen als Backend-Linie integrierbar





LABEL APPLICATOR

AUTOMATISIERTES AUFBRINGEN VON ETIKETTEN

Der LABEL APPLICATOR ist zum Drucken und Aufbringen einer großen Vielfalt von Etiketten auf unbestückte PCBs oder auf der Oberseite von bestückten PCB-Bauteilen entwickelt. Das System verwendet einen bürstenlosen Motor, um Etiketten in der gewünschten Position und im gewünschten Winkel aufzubringen.

EIGENSCHAFTEN

- Maschine zum automatischen Aufbringen von Etiketten auf Platinen oder auf elektronischen Bauteilen
- Version mit 1 Kopf (MODULO-LA-1HD) oder mit 2 Köpfen (MODULO-LA-2HD) mit Platzierung in 0-180 Grad
- Vereinfachte Programmierung zum Drucken von Texten, Zahlen, Codes etc.
- Mit eigenem Lesegerät steuerbare Kennzeichnung als Option
- Software-Schnittstelle für Etikettendrucker CAB / BRADY (Codesoft™) inklusive
- Druckt und bringt eine große Auswahl an Etikettengrößen auf (600 dpi-Drucker enthalten)
- Sehr große Platzierungspräzision +/-0,3 mm
- Mit Industrie 4.0 kompatibel



FUTURA F450

LASERMARKIERUNG

Die Lasermarkierung wird verwendet, um 2D-Codes, Barcodes oder Text auf Leiterplatten zu markieren. Bridge hat mit dem FUTURA F450 eine innovative Lösung entwickelt, um ein Produkt zu gewährleisten, das den höchsten Anforderungen entspricht.

EIGENSCHAFTEN

- Gleichzeitige Markierung von oben/unten mit 2 CO2-Lasern (F450)
- Markierbereich 350x350mm (oben) + 110x110mm (unten)
- Hohe Geschwindigkeit (>30% im Vergleich zu herkömmlichen Geräten)
- Hohe Präzision (Punktgröße 125um/5mil)
- Optische Kontrolle von Referenzmarken, optionale Zentralstütze und Erkennung von Bad Mark
- OCR- und Qualitätskontrolle (Automobilstandard)
- Handling mit automatischer Breitenanpassung (Fast Setup Change)
- Kompatibel mit Industrie 4.0 / MES





FLEX SERIES (1/2)

TRANSPORTSYSTEM FÜR SMD-LINIE

Die FLEX Serie ist das von Seica Automation angebotene Spitzenprodukt. Über eine Liste von Optionen können Sie vollständig personalisierte Module nutzen, um alle Anforderungen einer schnelleren und komplexeren SMD-Linie zu erfüllen.



REFERENZ	BESCHREIBUNG	PCB-ABMESSUNGEN	GESAMTABMESSUNGEN	GEWICHT
SA-FC-LC1S	Transportband, 1 Segment	510 X 390 mm	600 x 776 x 1052 mm	70 Kg
SA-FC-LC2S	Transportband, 2 Segmente	510 X 390 mm	1200 x 781 x 1172 mm	90 Kg
SA-FC-LC1S-I	Transportband, Inspektion, 1 Segment	510 X 390 mm	600 x 776 x 1052 mm	70 Kg
SA-FC-LC2S-I	Transportband, Inspektion, 2 Segmente	510 X 390 mm	1200 x 781 x 1172 mm	90 Kg
SA-FC-LC1S	Transportband, Inspektion, 1 Segment, Ofeneingang	510 X 390 mm	600 x 776 x 1052 mm	70 Kg
SA-FC-LC2S	Transportband, Inspektion, 2 Segmente, Ofeneingang	510 X 390 mm	1200 x 781 x 1172 mm	90 Kg
SA-FC-LC01S	Transportband, Inspektion, 1 Segment, Ofenausgang	510 X 390 mm	600 x 776 x 1052 mm	70 Kg
SA-FC-LC02S	Transportband, Inspektion, 2 Segmente, Ofenausgang	510 X 390 mm	1200 x 781 x 1172 mm	90 Kg
SA-FC-LC-WBOMESH	Ofenausgangsförderer mit Flachband	N/A	1411 x 655 x 925 mm	95 Kg
SA-FC-TLSC	Teleskopförderer	510 X 390 mm	1203/2003 x 773 x 1100 mm	90 Kg
SA-FC-WS1S	Arbeitsstation, 1 Segment	510 X 390 mm	1000 x 880 x 1889 mm	130 Kg
SA-FC-WS3S	Arbeitsstation, 3 Segmente	510 X 390 mm	1800 x 880 x 1889 mm	160 Kg
SA-FC-RS2L	Reparaturstation mit zwei Ebenen	510 X 390 mm	800 x 707 x 1752 mm	90 Kg





FLEX SERIES (2/2)

TRANSPORTSYSTEM FÜR SMD-LINIE

Die FLEX Serie ist das von Seica Automation angebotene Spitzenprodukt. Über eine Liste von Optionen können Sie vollständig personalisierte Module nutzen, um alle Anforderungen einer schnelleren und komplexeren SMD-Linie zu erfüllen.



REFERENZ	BESCHREIBUNG	PCB-ABMESSUNGEN	GESAMTABMESSUNGEN	GEWICHT
SA-FC-INV	Wender / Flip	510 X 390 mm	613 x 854 x 1287 mm	70 Kg
SA-FC-TU-T	Förderer, Typ „T“	510 X 390 mm	903 x 903 x 1172 mm	125 Kg
SA-FC-TU-L	Förderer, Typ „L“	510 X 390 mm	903 x 903 x 1087 mm	120 Kg
SA-FC-BUF-FLSM	FiFo-/LiFo-Puffer, 1 Rack	510 X 390 mm	1167 x 854 x 1702 mm	180 Kg
SA-FC-BUF-FFB	FiFo-/LiFo-Puffer, 25 Plätze	510 X 390 mm	606 x 903 x 1752 mm	180 Kg
SA-FC-1ML	1 Rack-Lader	510 X 390 mm	600 x 781 x 1172 mm	70 Kg
SA-FC-1MU	1 Rack-Entlader	510 X 390 mm	1210 x 854 x 1701 mm	280 Kg
SA-FC-2MU	2 Rack-Entlader	510 X 390 mm	1418 x 1250 x 1605 mm	280 Kg
SA-FC-3MU	3 Rack-Entlader	510 X 390 mm	1986 x 1253 x 1616 mm	280 Kg
SA-FC-4MU	4 Rack-Entlader	510 X 390 mm	1986 x 1253 x 1616 mm	280 Kg
SA-FC-MMU	Multi-Rack-Entlader (bis zu 16 auf Anfrage)	510 X 390 mm	2439 (min) x 853 x 1702 mm	120 Kg
SA-FC-SMUL	1 Rack-Lader und -Entlader	510 X 390 mm	1588 x 853 x 1702 mm	150 Kg
SA-FC-MMUL	Multi-Rack-Lader und -Entlader (bis zu 16 auf Anfrage)	510 X 390 mm	2936 (min) x 853 x 1702 mm	250 Kg

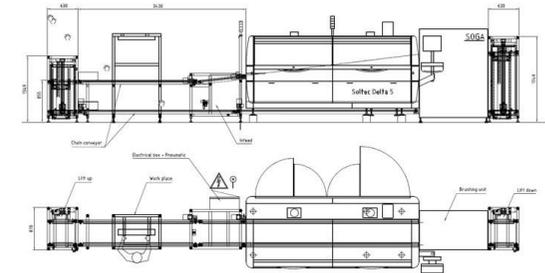
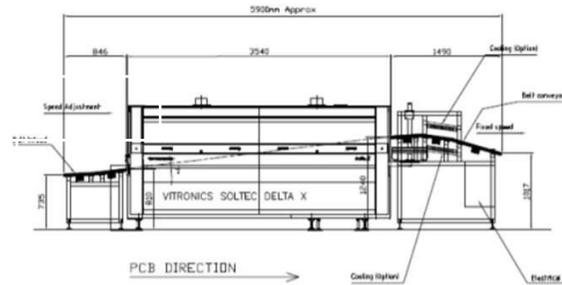




LÖTLINIE

TRANSPORTSYSTEM FÜR WELLENLÖT- ODER THT

Dank unserer Erfahrung in Wellenlötprozessen und der Automation sind wir in der Lage, komplette THT-Laserlötlinien mit personalisierten Konfigurationen zu liefern, die an alle Wellenlötmaschinen und Selektivlötmaschinen des Marktes angepasst werden können.





CANAVISIA S-BOX

KOMPLETTLÖSUNG FÜR DIE PRODUKTION

Canavisia hat ein nicht invasives intelligentes System entwickelt, das Industrie 4.0 kompatibel ist, um den Zustand von Industriemaschinen permanent zu überwachen, um etwaige Fehlfunktionen vorherzusehen, während gleichzeitig die Prozesse und die Produktionskosten optimiert werden.

EIGENSCHAFTEN

- Nicht intrusives System, das an jede Produktionslinie angepasst werden kann
- Vorausschauendes Wartungsmanagement, Überwachung und Verwaltung von Vermögen, Optimierung, Energieüberwachung, Geschäftsanalytik
- Mit SE-MASTER ausgestattete Hardware-Lösung, die Daten von auf den Maschinen installierten Überwachungsmodulen über die Module SI-MONITOR sammelt und auswählt
- Kann an jeden Sensor mit analogem Ausgang von 0 bis 10 V (oder alternativ von 4 bis 20 mA) angeschlossen werden: Sensor für Schwingungen, Druck, Helligkeit, Verbrauch, Zustand des Leuchtturms, Bewegung, Luftmenge etc.
- Integriert digitale Ausgänge, um die Inbetriebnahme, das Ausschalten und die Einstellung der Intensität zu steuern (Beispiel: Geschwindigkeit eines Ventilators)
- Kommuniziert in Wi-Fi, 3G oder 4G über die Protokolle ModBus, TCP Client/Server, IPC CFX



CANAVISIA SUITE SOFTWARE

EXPERTENSOFTWARE FÜR DIE S-BOX-ÜBERWACHUNG

Als Ergänzung zur S-BOX bietet Canavisia die Entwicklung von spezifischen Dashboards ausgehend von ihrer Software an. Alle Sensoren werden von einer Steuerungssoftware auf einer Windows-Plattform mit der Möglichkeit angezeigt, die Mitteilungen an Benutzer zu personalisieren.

EIGENSCHAFTEN

- Erstellen personalisierter Dashboards.
- Verfolgung des Betriebs und des Einsatzes von Maschinen in Echtzeit
- Fernsteuerung
- Überwachungskontrolle des Energieverbrauchs
- Alle Sensoren werden in der Steuerungssoftware angezeigt und sind aus der Ferne einzeln abfragbar
- Möglichkeit, die Mitteilungen an Benutzer zu personalisieren: Textnachrichten auf dem Bildschirm oder mit Sprachausgabe, E-Mail
- Mögliche Datenspeicherung auf abgesichertem Webserver (Cloud), auf MES oder lokal auf der speziellen Datenbank möglich
- Mobile Anwendung als Option



Technischer Support

Unsere Mitarbeiter sind an allen Testsystemen ausgebildet und reagieren schnellstmöglich auf Ihre Anfragen.

Abhängig von Ihren individuellen Bedürfnissen bieten wir Ihnen verschiedene Optionen für Wartungs- und Serviceverträge an.



Schulungen

Während der Installation Ihrer Maschine schulen wir Ihre Mitarbeiter in der Verwendung des neuen Testsystems.

Vom Basistraining bis hin zu Intensivtraining für erfahrene Nutzer bieten wir individuelle Schulungen an.



Testanwendungen

Unseres Testingenieure entwickeln nach Evaluierung Ihrer Anforderungen an den Test die entsprechenden Programme und Testadapter (Fixture).

Unsere neue Adapterfertigung wurde speziell für die Implementierung von Produkten entwickelt und ermöglicht es, voll auf Ihre Bedürfnisse bei der Entwicklung von Fixtures einzugehen.





www.seica.com/de/



+49 7243 6525310



Folgen Sie uns!

